

ダイピロキサイド 特殊グレード

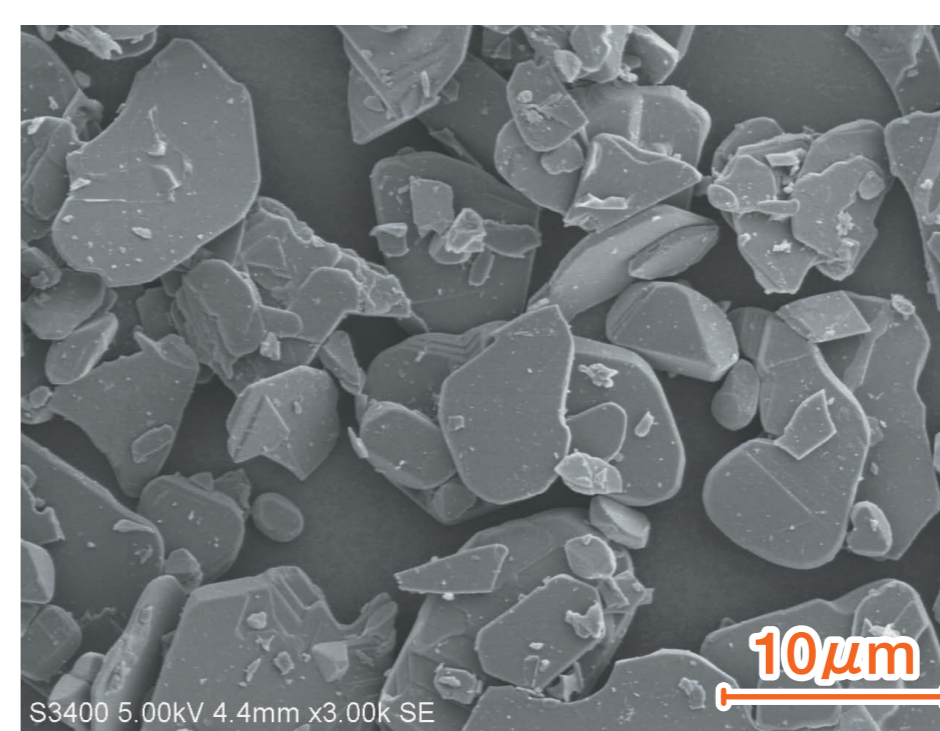
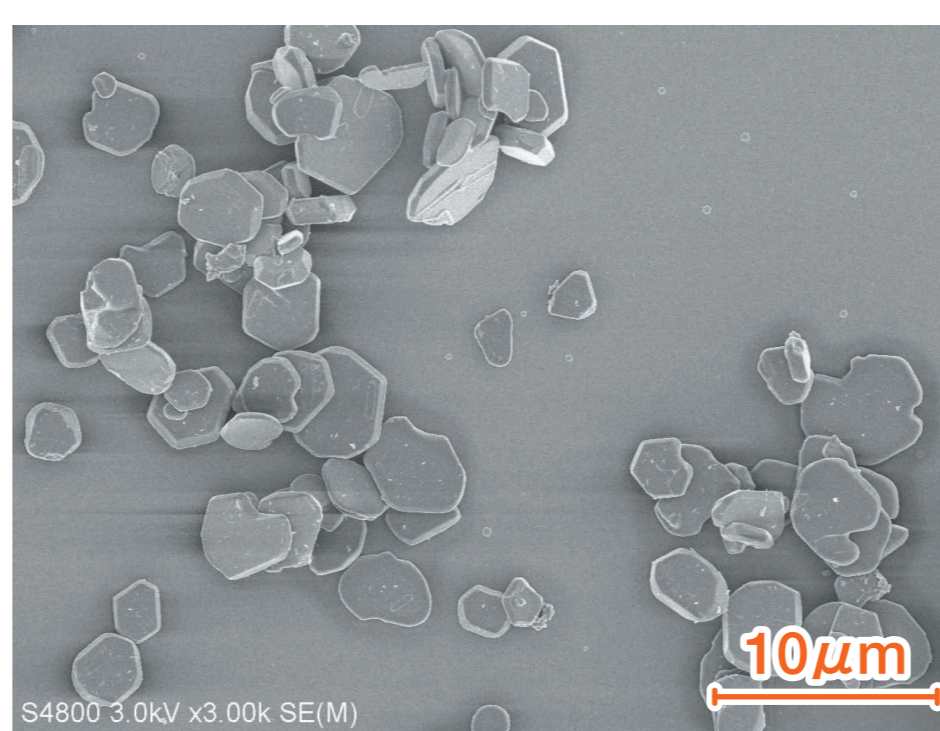
異種金属の複合化技術による**粒子径・形状制御**、**表面改質**による機能性を付与したグレードです。

盤状シリーズ

- 丸み盤状タイプ (低アスペクト比) ■ 低摩耗性 ■ 充填性○(鱗片粒子比)
- サブフィラーとして真球・鱗片粒子とのハイブリッド○
- 樹脂配合時に樹脂の特性を大きく損なうことなく放熱性を付与

ラインナップ

銘柄	#7504	#7508
粒子サイズ	4μm	8μm



代表的な板状粒子との性能比較(※代表値)

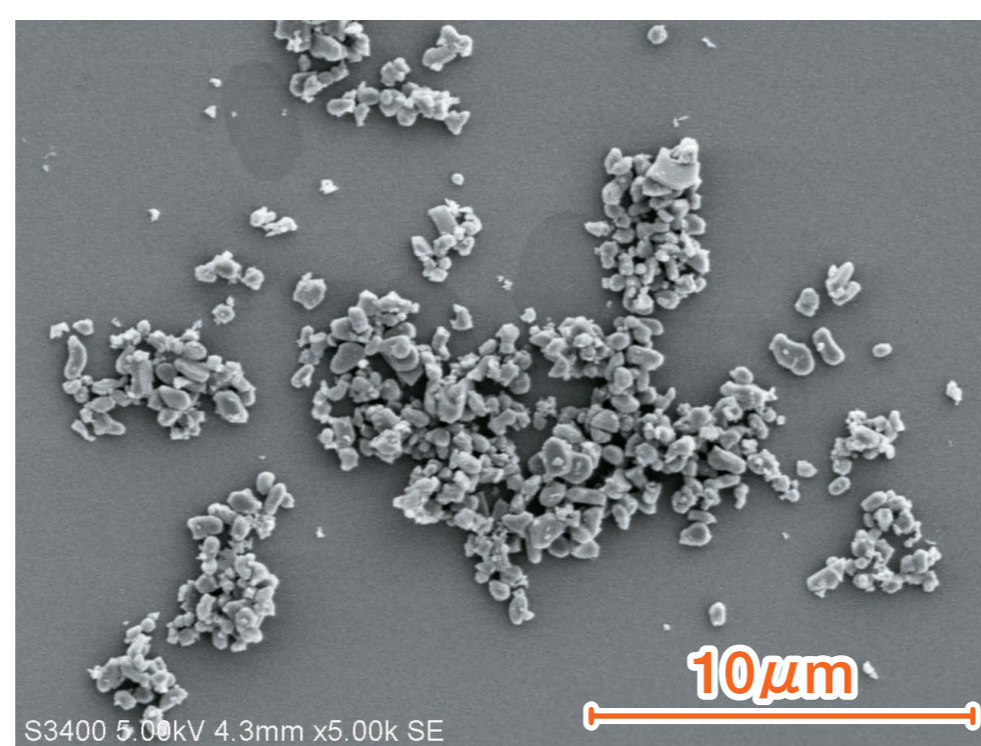
	熱伝導率	充填性	アスペクト比	コスト
タルク	△	△	30~50	◎
窒化ホウ素	◎	×	20~40	×
ダイピロキサイド#7504	○	○	5	△~○

新規開発中

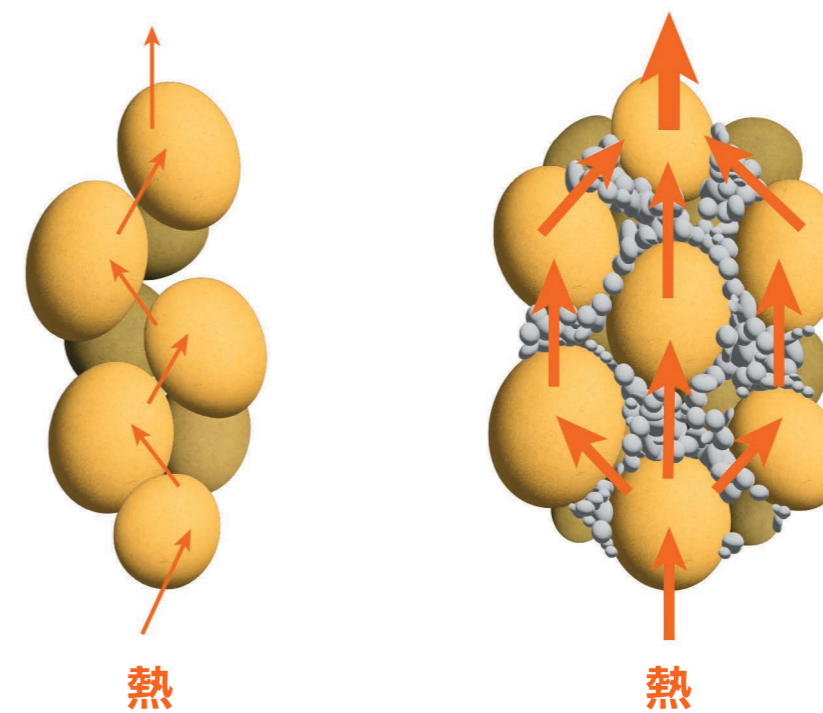
①サブミクロンタイプ

- 超微粉タイプ ■ 充填性○ ■ サブフィラーとして最密充填に適用しやすい粒径

銘柄	#7314
粒子サイズ	0.4~0.5μm



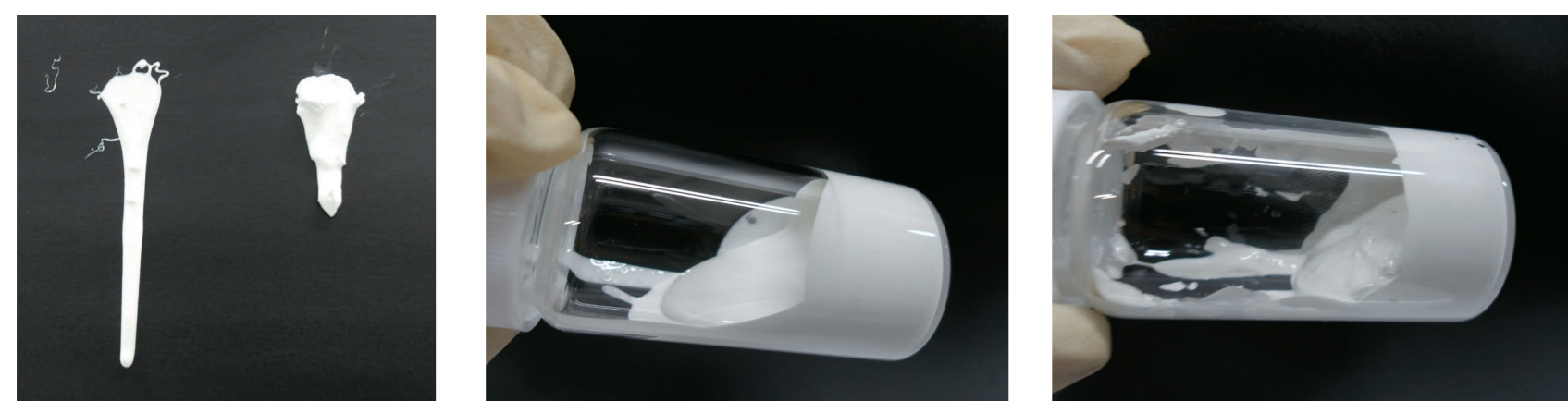
サブフィラーなし サブフィラーあり



大きな粒子同士の間隙に入れる粒径のため、充填密度が向上。

熱の伝達経路が増え、熱伝導性の向上を可能にします。

②表面処理タイプ



- 湿式での緻密処理により、樹脂との相溶性向上が可能です。
- 樹脂種に合わせた処理品を提案可能ですのでご相談ください。

③低誘電正接タイプ

*) 10GHz、粉体で評価、代表値

	熱伝導率	比誘電率*	誘電正接*
熔融シリカ	△	2~3	0.002
アルミナ	△~○	4~5	0.001
低誘電正接タイプ	○	4~5	0.0002

- アルミナ比で一桁低い誘電正接を実現。高熱伝導を付与しつつ、誘電正接を低く抑えることが可能です。

本物性データは、所定の試験方法における当社評価値であり、実際の適用結果を保証するものではありません。